



平成 26 年 11 月 17 日

各 位

会社名 株式会社三井ハイテック
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠
(コード番号 6966 東証第 1 部・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 白川 裕之
(TEL 093-614-1111)

IC 組立事業の清算に関するお知らせ

当社は、当社取締役会において、以下のとおり、平成 28 年（2016 年）12 月末を目処に電子部品セグメントの一部である IC 組立事業を清算することを決定しましたのでお知らせします。

1. 事業清算の理由

当社では、1984 年に IC 組立事業を開始し、それまでの金型製造およびリードフレーム製造に加えて半導体製造の最終工程である組立ならびにテストまで一貫した生産体制を構築し、半導体産業の発展に寄与して参りました。

しかしながら、近年の半導体業界における再編が加速していく中、競合他社との価格競争は激化しており、利益を確保し続けることが困難な状況となっております。

当社はこれまでお取引先様のニーズにきめ細やかに対応した製品の提供をはじめとする営業努力や、合理化によるコスト低減に取り組んで参りましたが、将来を見通しても、当社を取り巻く事業環境は今まで以上に厳しくなると予測されます。

この様な状況を鑑み、IC 組立事業の清算を決断するに至りました。

今後は、当該事業の経営資源を成長事業に集中させ、さらなる強化を図って参ります。

2. 清算する事業の概要

IC 組立事業では、IC チップをお取引先様からお預かりして半導体パッケージを組み立てる受託加工ならびに完成した半導体パッケージのテストを行って参りました。当該事業の売上規模は当社連結売上高の約 3%にあたります。

当該事業を行っている事業所の概要は以下のとおりです。

住 所	熊本県菊池郡大津町大字高尾野 272 番地 15
名 称	熊本事業所
従業員数	133 名（パートタイマーを含む、10 月末現在）

3. 清算日程

現在、取引を継続していただいているお取引先様への影響を最小限とするため、段階的な縮小を図りながら、最終的には平成28年（2016年）12月末を目処に清算いたします。

4. 今後の見通し

当該事業の清算による業績への影響について現在精査中ですが、今期の業績には大きな影響はありません。

以上